



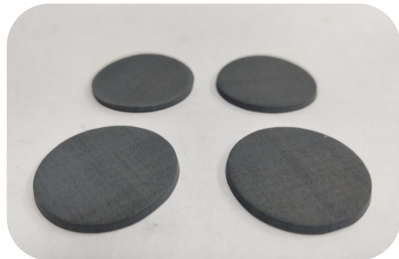
鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HFS-30

【高效能导热垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 高热导率和低热阻
- 低应力装配
- 良好的热稳定性能
- 多种厚度选择，应用范围广

应用领域推荐：

- 卫星，雷达等军事领域
- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：

阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	黑灰色	---	目视
标准尺寸	120*120	mm	ASTM D 5947
厚度	0.5~3	mm	ASTM D374
硬度	65(± 10)	Shore 00	ASTM D 2240
密度	3.4(± 0.2)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.1	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥ 100	%	ASTM D 412
撕裂强度	≥ 0.5	N/mm	ASTM D 624
压缩比	≥ 40 (@50Psi)	%	ASTM D 695
使用温度	-50~150	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	12.0(± 3)	W/m \cdot K	ASTM D 5470
热阻	≤ 0.3 (@20Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

不同压缩量对应的瞬间应力

